

深圳市联得自动化装备股份有限公司  
投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员 姓名	兴业证券 张萍 金元证券 黄斌 中信期货 阎勇 德邦证券 师浩云 玖金基金 纪锐 涌瑞基金 杨文亮 邦得太一基金 潘奕成 广源汇富 曾勇 兆利丰 李名城 锦洋基金 朱韦潼 启汇财经 王倩玉 万链投资 谷志明 力得资本 邓鹏 红荔湾基金 王海波	
时间	2023年9月4日下午3:30	
地点	东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室	
上市公司接待人员 姓名	董事、副总经理：胡金先生 董事、董事会秘书：刘雨晴女士	
投资者关系活动主要 内容介绍	<b>一、介绍公司概况</b>  简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公	

司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。

## 二、投资者会议问答交流

### Q1: 公司主要产品包括哪些设备?

A1: 公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、锂电装备的研发、生产、销售及服务。公司主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺寸 TV 整线设备、移动终端自动化设备、汽车智能座舱系统组装设备、Mini/MicroLED 芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、半导体倒装设备、固晶设备、AOI 检测设备、引线框架贴膜设备、锂/钠电池模切叠片设备、电芯装配段及 pack 段整线自动化设备。

### Q2: 公司和华为有哪些业务合作?

A2: 公司同华为开展了广泛合作, 主要包含屏幕制造及整机组装智能化装备, 5G 模块生产设备, 汽车电机电池组装智能设备等, 公司同华为建立了良好稳定的深度合作关系。

### Q3: 公司目前的研发技术人员有多少, 研发费用是否有增长?

A3: 目前公司研发技术人员 710 名左右, 约占公司人员总数的 42%。今年上半年研发支出 6075.8 万, 同比增长 44.35%, 在研发投入上持续增长。

### Q4: 公司在汽车电子领域有哪些客户?

A4: 在汽车电子领域, 公司积累了如大陆汽车电子、博世、伟世通等诸多世界 500 强的客户资源, 并建立了良好的合作关系。汽车智能化的发展促使汽车智能座舱系统在整车中扮演越来越重要的角色, 带来汽车智能座舱系统相关设备的需求不断壮大, 公司在该行业的布局逐渐在订单中变现, 特别是公司与国外大客户的深度合作, 实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。

### Q5: 目前 Mini/Micro LED 的市场环境如何, 公司在该领域有哪些设备?

A5: 继 OLED 显示技术后, Mini/Micro LED 是近年来新兴的下一代显示技术, 目前正处于快速发展的阶段, 预计未来几年会保持高速增长。公司目前在 Mini/Micro LED 领域, 已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、

检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。

**Q6: 公司目前锂电设备领域进展如何?**

**A6:** 在锂电设备领域, 公司持续增加在锂电池包蓝膜、注液机、切叠一体机、电芯装配及 Pack 段整线自动化设备等设备上的研发投入, 实现了从 0 到 1 的突破, 并形成销售订单。

**Q7: 公司目前半导体封测项目进展如何?**

**A7:** 公司凭借研发成功的半导体 IC 封装设备顺利切入半导体封测行业, 已完成 COF 倒装共晶、共晶及软焊料等固晶设备、AOI 检测、引线框架贴膜和检测设备的研发, 并形成销售订单。公司将加快推进技术研发和市场开拓, 努力实现业务快速增长。

**Q8: 公司有没有实行股权激励计划?**

**A8:** 为了进一步健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才, 充分调动员工的积极性, 促进公司长远发展, 公司于 2023 年 4 月 17 日召开股东大会审议并通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》, 向符合条件的 180 名激励对象授予限制性股票 246.25 万股, 其中, 首次授予 197.00 万股, 预留 49.25 万股。

**Q9: 公司未来的发展战略是什么?**

**A9:** 公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及锂电装备几大领域的技术研发及市场开拓。在技术方面, 积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/MicroLED 设备、VR/AR 精密组装设备, 汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及锂电中后道装备在新兴领域的应用市场, 同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度, 支撑该业务快速成长。在市场方面, 公司紧紧把握住现有国内客户的设备开发订单的同时, 也大力开拓海外市场, 特别是海外汽车智能座舱系统装备及锂电装备市场。公司将通过多维度的产品布局, 丰富产品种类, 完善产品体系, 通过内延发展孵化研发团队模式, 形成稳健持续的发展平台。公司将进一步增强自身实力、在国内外市场竞争中及时跟进并紧密契合、满足不同客户的个性化需求, 拓宽销售渠道, 进一步扩大国外市场占有率, 提升自身市场竞争力和市场品牌影响力。

	<p><b>三、公司生产车间参观</b></p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023-09-04